

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

プリント基板のメッキ処理装置

[公開編]平成8年~平成12年(5年間) 71点

全文収録 全文公報版 ¥27,700-

既刊関連セットのご案内

No,8579	登録・公開	バレルメッキ方法と装置	平.9-10	76点	¥30,000
No,8084	公告・公開	"	平.7-8	73点	¥29,700
No,7797	"	"	平.5-6	66点	¥23,000
No,7558	"	"	平.3-4	109点	¥39,200
No,7158(B)	公開特許	"	平.2	30点	¥11,000
No,"(A)	公告特許	"	昭.60-平.2	89点	¥31,600
No,8641(B)	公開特許	電気めっき用治具とめっき方法	平.8-10	90点	¥31,300
No,"(A)	"	"	平.5-7	91点	¥31,000
No,8865	公告特許	"	平.6-11	80点	¥27,700
No,8863	"	リードフレームのメッキ方法と装置	平.6-11	53点	¥20,400
No,8868	公開特許	半導体ウェーハのメッキ方法と装置	平.5-11	103点	¥35,000
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-11	75点	¥29,700
No,8496	"	ガラスへのメッキ処理方法	平.5-9	60点	¥23,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	¥27,800
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-11	81点	¥31,600
No,8936	"	チタン合金の表面硬化方法	平.5-11	71点	¥26,700
No,8937	"	チタン材のエッチング方法と浴の組成	平.5-11	59点	¥24,500
No,8938(A)	"	チタンの着色加工方法	平.7-11	57点	¥22,400
No,"(B)	"	チタンのメッキ加工方法	平.7-11	55点	¥21,600
No,8924	"	マグネシウム合金の表面処理方法	平.9-11	48点	¥19,300
No,8826	"	メッキ剥離剤の組成と剥離方法	平.9-11	67点	¥24,800

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、FAX,郵便にてお送りください。(お電話でも承ります)
 [原本コピーはB5サイズ・目次製本済みです。2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No, _____ 全文公報版
所属部署	題 名
担当者名	合計 ¥ _____
	() Fax ()
住所 〒 _____	

プリント基板のメッキ処理装置 No, 9087

[公開編]平成8年～平成12年 71点

全文公報版 ¥27,700

日本特許公開平成8年

- 1 プリント基板のメッキ用ハンガー
日立電線(株)
- 2 液中集電法によるプリント回路用銅箔表面処理方法
日鉱ゴールド・フォイル(株)
- 3 薄形基板のめっき装置
国際電気(株)
- 4 電解めっき方法、電解めっき装置、電解めっき用ラック
イビデン(株)
- 5 電気メッキ用の非伝導性基質の製造方法
マクダミット Inc.
- 6 プリント基板のめっき方法
荏原1-ジライト(株)

日本特許公開平成9年

- 7 電気メッキ装置
有相模商会
- 8 プリント配線基板の電気メッキ装置
イビデン(株)
- 9 板状ワークのめっき方法及び装置
上村工業(株)
- 10 無電解金めっき方法及び無電解金めっき装置
"
- 11 ディスク状のワークを処理するための装置
シーメンス SA
- 12 プリント基板を処理するための装置
"
- 13 プレート状の工作物、殊にプリント配線板の電解加工処理装置
"
- 14 プリント基板等の銅パタンの表面処理方法及び装置
広繁勝也
- 15 無電解めっき方法及び装置
有オーシャン
- 16 自動液体処理ライン
栄電子工業(株)
- 17 めっき装置
イビデン(株)
- 18 電解めっき方法及び電解めっき装置
"
- 19 めっき装置
"

日本特許公開平成10年

- 20 プリント配線板のスルホールメッキ方法
松下電工(株)
- 21 プリント基板めっき用の保持ラック
栄電子工業(株)
- 22 プリント基板メッキ用治具
株大野s/s
- 23 プリント配線基板の基板保持用治具とその取付装置
株マルヤs/s
- 24 プリント基板の表面処理用保持治具
東芝ケミカル(株)
- 25 プリント配線基板の製造方法及びこれに用いるメッキ用治具
ソニー(株)
- 26 電気メッキ装置の製品搬送機構
小林秀行
- 27 ポリマーフィルムを連続的に金属被覆する方法および装置ならびにこれにより製造される製品
ゴールド・エレクトロニクス Inc.
- 28 メッキ装置
渡辺智司
- 29 プリント基板の試作方法及び同装置
株プリント電子総業
- 30 無電解めっき装置及びめっき方法
富山日本電気(株)

- 31 配線基板への予備はんだ表面を平坦な面に形成する方法
株弘輝
- 32 化学銅めっき装置
株日立s/s
- 33 電気めっき処理装置のワーク支持具
丸仲工業(株)
- 34 メッキ処理装置
旭技研(株)
- 35 電解処理装置
イビデン(株)

日本特許公開平成11年

- 36 プリント配線板の製造装置
エルナー(株)
- 37 プリント配線板のめっき装置
富山日本電気(株)
- 38 処理液の循環方法およびこれを利用した電解めっき装置
荏原1-ジライト(株)
- 39 プリント基板メッキ用治具
株大野s/s
- 40 基板のめっき方法及び装置
荏原1-ジライト(株)
- 41 表面処理装置
住友ベークライト(株)
- 42 均一メッキ処理を可能にした電気メッキ処理システム
丸仲工業(株)
- 43 プリント配線基板の表面処理方法及びその装置
株メイシン
- 44 リフロー装置
ソニー(株)
- 45 処理槽の放熱および排気削減方法
荏原1-ジライト(株)
- 46 基板のめっき方法及び装置
"
- 47 均一メッキ処理を可能にした電気メッキ処理システム
丸仲工業(株)

日本特許公開平成12年

- 48 プリント基板保持用治具及びめっき装置
荏原1-ジライト(株)
- 49 プリント基板のめっき装置
荏原1-ジライト(株)
- 50 電解銅箔の製造方法、電解銅箔、銅張り積層板およびプリント配線板
三井金属鉱業(株)
- 51 金属めっき膜の製造方法、金属めっき膜形成阻害物質除去材及びめっき装置
イビデン(株)
- 52 電気めっき方法、電気めっき装置および電子部品
TDK(株)
- 53 連続メッキにおける板状被メッキ物の搬送方法および装置
栄電子工業(株)
- 54 プリント基板メッキ用治具
株大野s/s
- 55 プリント基板の電解メッキ用治具
日本特殊陶業(株)
- 56 プリント基板の保持装置
荏原1-ジライト(株)
- 57 プリント基板メッキ用治具
株大野s/s
- 58
"
- 59 電解めっき方法および陽極構造体
沖電気工業(株)
- 60 メッキ用搬送方法と搬送間隔調製装置及びメッキ装置
ケミトロン(株)
- 61 均一メッキ処理を可能にした電気メッキ装置システム
丸仲工業(株)
- 62 メッキ方法とその装置
ケミトロン(株)

- 以下9点省略 -

題名	出願人	年度
日本特許公開		
63 めっきアノード電極用銅または銅合金ボールの製造方法	三菱マテリアル(株)	平成12年
64 ポリマーフィルムを連続的に金属被覆する方法および装置ならびにこれにより製造される製品	ゴールド・エレクトロニクス Inc.	〃
65 高速電流反転めっき用電源装置	(株)三社電機s/s	〃
66 メッキ処理装置	旭技研(株)	〃
67 薬液処理装置	東京化工機(株)	〃
68 添加剤供給監視装置	(株)ケミトロン	〃
69 メッキ処理装置	旭技研(株)	〃
70 メッキ方法及びメッキ装置	横河電機(株)	〃
登録実用新案		
71 プリント基板挟持具	日本ラック(株)	平成12年

